# ホールプレートの校正法とそれによる座標測定機の性能評価\*

# 和合 健\*\*、池 浩之\*\*

高精度座標測定機を使用して、環境温度に依存しない低熱膨張特性を有する低熱 膨張セラミックス製ホールプレートへの目盛り付け方法を試み、その不確かさを求 めた。さらに、ホールプレートを利用した座標測定機の性能検査を行い、その検査 様式を示した。その結果、低熱膨張セラミックス製ホールプレートの校正値の不確 かさは、測定長さ 350mm では U(k=2)=444nm と算出され、ブロックゲージなど温度 膨張材の場合と比較して温度膨張に起因する因子の不確かさが排除できるため不確 かさが小さく算出された。

# キーワード:座標測定機、ホールプレート、低熱膨張セラミックス、性能検査、値 付けの不確かさ

Holeplate Calibration and Performance of Coordinate-Measuring Machine incorporating Holeplates

# Takeshi Wago and Hiroyuki Ike

After calibrating holeplates using a reverse method based on a high-precision coordinate-measuring machine (CMM), we calculated the uncertainty in calibration. The CMM performance is demonstrated by comparing the measured dimensions of holeplates against its design values. The result allowed us to calculate the uncertainty in calibration of holeplates made from ceramics with a low thermal-expansion coefficient. For a measurement length of 350 mm, an uncertainty U(k=2) = 444 nm was obtained, which is less than that obtained with materials with normal coefficients of thermal expansion (e.g., gauge block).

key words : coordinate-measuring machine, holeplate, low coefficient of thermal expansion ceramics, evaluation of performance, uncertainty of calibration

### 1緒 言

ホールプレート(以下、HPという)は、二次元的に円 筒を配置した標準器であり、座標測定機(以下、CMMと いう)の精度検査や補正テーブル作成に使用されている。 HPは低膨張ガラス、インバー合金及び炭素繊維を筐体と して測定要素の円筒穴を機械加工で仕上げたものや、円 筒ブッシュを埋め込んだものなどが提案・市販されてい た。しかしながら、円筒ブッシュを埋め込んだものでは 値付け精度の問題点、個々の材料の筐体においても経年 変化、難加工性などの多くの問題点を有していた。ここ で使用した HP は低熱膨張セラミックスを筐体としたも ので、機械加工性が良好、経年変化が小さい、かつ比剛 性(ヤング率/密度)が高く大型 HP(□500 mm 以上) へも対応可などの優位な特性を有している。

HPはCMMの性能検査や校正での有効性が高く、広く 日本国内の製造産業で稼働するCMMに適用することで CMMの検査及び校正技術が向上すると予想される。HP を広く普及させるためには、全国の公設試においてHP の値付け校正ができること、HPを使用した検査方法技術 が蓄積されていることが必要になる。

ここでは、産業技術連携推進会議知的基盤部会計測分 科会形状計測研究会の共同研究として、パイロットラボ が示したプロトコルに従い、HPの値付け校正とHPを使 用した性能検査を実施した。特に、環境温度に依存しな い低熱膨張特性を有する低熱膨張セラミックス製 HP が 示す校正値の不確かさの大きさ及びその算出方法、さら に、CMM の性能検査を実施するための治具による固定方 法やワーク座標系の設定方法などを把握し、その検査様 式を示した。

### 2 実験方法

実験に使用した CMM は UPMC550-CARAT (Carl Zeiss)、 ソフトウエアの OS は Windows XP、CMM のソフトウエ アのバージョンは UMESS-LX Ver1.0、最終メーカ校正日 は平成 25 年 1 月 22 日である。CMM は門移動型の構造で プローブはパラレルツイン式の 3D プロービングが行え

<sup>\*</sup> 平成 24 年度 產業技術連携推進会議知的基盤部会計測分科会形状計測研究会(共同研究)

<sup>\*\*</sup> ものづくり基盤技術第2部(現素形材技術部)

るプローブである。CMM の指示誤差は MPEE=0.8+L/600 µm (L は測定長さ mm) である。相互測定での測定期日 は平成 25 年 2 月 4 日~3 月 1 日、グループは A ループ、 HP No.1 である。トレーサビリティの道筋は、国家標準→ ホールステップゲージ→HP である。

### 3 HP への値付け

### 3-1 固定方法

プロトコルでは HP とホールステップゲージ(以下、 HSG)の二つのゲージの固定の制限として、直接 CMM テーブルに固定してはいけないことを指示している。他 のゲージ固定に関する指示事項は、付属の支持台の使用 は必須ではないこと、熱によるゲージの膨張を阻害しな い固定方法にすることのみを指示している。ここでは、 写真1に示すとおり、CMM テーブルの上に補助石定盤を 置き、その上にT型治具を置いた構造とした。補助石定 盤は自重のみで位置が固定できると予想して直接的に CMM テーブルとネジ止等の固定は行わなかった。付属の T型治具は写真1のとおり補助石定盤に2箇所をクラン プで固定した。反転法による測定で、反転後の位置の再 現性を確保するために写真2のとおり CMM テーブルに 付き当て板を2箇所設置した。

### 3-2 測定物座標系

HPの値付けを行うためには、そこで使用する CMM に 正確な目盛を与えることが必要であり、その目盛補正方 法は国家標準にトレーサブルな寸法標準器を利用して行 われる。ここでは、その寸法標準器として HSG を用いて CMM の目盛校正を実施した。この HSG による CMM の 目盛校正が HP への値付けにおいて最大の要点であると 考えた。

HSG により行った目盛校正値を HP 測定へ適切に受け 渡すためには、HP 測定での測定物座標系(以下、WCS) のX軸(回転軸)とHSG 測定でのWCSのX軸(回転軸) をほぼ一致させる必要がある。ここでは二つのゲージの X 軸を揃える方策として補助石定盤の-Y 側端面を利用 した。この補助石定盤の端面を CMM の機械座標系(以 下、MCS)に揃えて配置することで、この補助石定盤の 端面を利用して二つのゲージ間の X 軸を容易に揃えるこ とができると考えた。そこで T型治具と補助石定盤の-Y端面をプレートに付き当てて揃えた。CMM テーブル上 の2箇所の付き当て板に補助石定盤を押しつけて、T型 治具の-Y端面のY軸方向の出入りを図1に示す点1と 点2の位置で測定した。その結果、機械座標系で点1が Y0 mm、点2が-0.0578 mm となり Y 軸方向の出入りは 0.0578 mm であった。次に HP は反転法を利用することか ら、補助石定盤上にT型プレートを固定したままでZ軸 を回転中心として補助石定盤を180°回転させ、CMMテ ーブル上の付き当て板に補助石定盤を押し当てた状態で 図2に示す点3と点4のY座標を測定したところ、点3 はY322.3953 mm、点4はY323.7826 mm となり Y 軸方向 の出入りは1.3873 mm であった。



写真1 「型治具の固定方法



写真2 CMM テーブル上の付き当て板



図1 T型治具のY軸出入り測定(回転前)



図2 T型治具のY軸出入り測定(回転後)





写真3 D0の姿勢



図4 使用したスタイラス

HP 測定での WCS は図 3 のとおり空間軸は HP の上端 面を平面 4 点測定した時の法線ベクトルとし、回転軸 (X 軸) は No.1 円と No.8 円で成す直線、X、Y 軸のゼロ点は No.1 円の中心座標、Z 軸のゼロ点は HP の上端面から Z -15 mm 平行移動させた HP の中立面上の点とした。

### 3-3 反転法による測定

HP は写真3 に示すD0、DX、DY、DZ の4通りの姿勢 で測定した。測定方法はNo.1→No.8→No.15→No.22→ No.1 の順による Forward 方向、続いてNo.1→No.22→ No.15→No.8→No.1 の順による Backward 方向となる行 きと帰りを1 セットとして測定し、繰り返しは無しとし た。ただし、HP 測定でのCMM の測定の不確かさを求め るためにD0のみ繰り返し5回の測定をした。NC プログ ラム作成では、ボールプレートの時とは異なる外側1列 の配列のためにループを入れ子にする必要が無かったた めに容易にNC プログラムが作成できた。

NC プログラムは D0、DZ 用と DX、DY 用に1 個ずつ 用意し、座標系変換 DI1711 で D0 が 1、DZ が 3、DY が 7、DX が 5 を設定することでこの二つの NC プログラム のみで測定対応ができた。1 姿勢あたりの Forward + Backward 測定に要する測定時間は 22 分であった。スタ イラスは図 4 に示す鉛直下向きの  $\phi 8 \text{ mm}$ チップの赤色 ルビーを使用した。

### 3-4 HP 測定での温度変動

HP 測定中の温度は CMM 内蔵温度計の検知部を CMM テーブル上に接触させて測定した。D0、DX、DY、DZ の4 姿勢の測定を通しての温度の平均値は 19.23 ℃、変動幅は 0.1 ℃であった。HP の線膨張係数がほぼ 0 /℃であるため、HP 測定で温度補正は行わなかった。



写真4 HSGのX軸の姿勢



写真5 HSGのY軸の姿勢



### 4 ホールステップゲージによる目盛校正

#### 4-1 固定方法

HSG は写真4のとおり補助石定盤上に付属のパラレル ブロックを敷き、その上に HSG を置いた。HSG の固定 方法は、自重に加えて2個のVブロック挟み込む方法と し、クランプ等で固定しなかった。

#### 4-2 測定物座標系

HSG の設置要点は HP と回転軸方向が一致するように 設置することである。X 軸方向の設置では、写真 4 のと おり CMM テーブル上の付き当てに押し当てた補助石定 盤の-Y 端面を起点として、長さ 150 mm のパラレルブ ロックを利用して MCS の X 軸に揃えた。Y 軸方向の設 置では写真5のとおり補助石定盤を90°回転させてCMM テーブル上の付き当てに押し当てて、長さ75 mmのブロ ックゲージを利用した補助石定盤の基準端面からの長さ を一定に揃えて、HSGのY軸方向の向きがMCSに一致 するようにした。ここで補助石定盤の右側端面のX座標 を図5に示す点5と点6の位置で測定したところ、点5 がX269.6867 mm、点6がX270.1251 mmでありX軸方向 の出入りは0.4384 mmであった。HSGのWCS は図6の とおり空間軸は上端面で平面4 点測定の法線ベクトルと し、回転軸は左側から3 個目の円と10 個目の円の成す直 線とし、X、Y軸のゼロ点は左側から3 個目の円の中心座 標、Z軸のゼロ点は上端面から Z-30 mm 平行移動させ た中立面上の点とした。

### 4-3 HSG の測定

HSG の測定は X-50 mm の穴から右に 10 個目までの 穴を円測定し、繰り返しは 5 回とした。Y 軸上に置いた 時も同様である。測定時間は X 軸、Y 軸とも 20 分を要 した。スタイラスは図 4 に示す鉛直下向きの  $\phi 8$  mm チ ップの赤色ルビーを使用した。

### 4-4 HSG 測定での温度変動

HSG 測定中の温度は CMM 内蔵温度計の検知部を CMM テーブル上に接触させて測定した。HSG 測定中の 温度の平均値は 19.3 ℃、変動幅は0 ℃であった。HSG の 線膨張係数がほぼ 0 /℃であるため、HSG 測定で温度補 正は行わなかった。

### 4-5 値付けの不確かさの算出

- (1) 長さに依存しない項
- ・ σ(CMM): CMM の測定の不確かさ(Aタイプ)
  → HP 測定の繰り返しの標準偏差: D0 姿勢、112 円(行)
- き帰り、 XY) ×繰り返し5回
- ・ σ(Mcali) : HSG の値付けの不確かさ (B タイプ)
  →パイロットラボの提示値(k=2)

#### (2) 長さに依存する項

・o(bias): CMM の偏りの不確かさ(Aタイプ)
 →この因子は目盛補正をしているのでバジェット表か

表1 ホールプレートの値付け測定結果

	ホール中心の座標(mm)				
ホール番号	Х	Y			
1	0.0000	0.0000			
2	50.0000	0.0001			
3	99.9993	-0.0006			
4	149.9981	-0.0004			
5	199.9969	0.0001			
6	249.9954	-0.0003			
7	299.9879	-0.0006			
8	349.9918	0.0000			
9	349.9917	50.0014			
10	349.9916	100.0019			
11	349.9898	150.0013			
12	349.9891	200.0025			
13	349.9883	250.0049			
14	349.9881	300.0056			
15	349.9879	350.0075			
16	299.9865	350.0089			
17	249.9876	350.0093			
18	199.9885	350.0098			
19	149.9906	350.0103			
20	99.9914	350.0110			
21	49.9989	350.0115			
22	0.0016	350.0119			
23	0.0014	300.0099			
24	0.0014	250.0085			
25	0.0022	200.0069			
26	0.0034	150.0068			
27	-0.0009	100.0036			
28	-0.0008	50.0017			

#### 表2 ホールステップゲージを使用して求めた

# CMM の目盛誤差

X嘂_CMM			Y 嘂_CMM		
測定値	標準値	誤差	測定値	標準値	誤差
-50.0005	-50.0000	-0.0005	-50.0005	-50.0000	-0.0005
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49.9976	49.9975	0.0001	49.9976	49.9975	0.0001
99.9937	99.9934	0.0003	99.9938	99.9934	0.0004
149.9919	149.9916	0.0003	149.9920	149.9916	0.0003
199.9919	199.9917	0.0002	199.9920	199.9917	0.0003
249.9909	249.9908	0.0000	249.9910	249.9908	0.0002
299.9899	299.9896	0.0003	299.9898	299.9896	0.0001
349.9898	349.9896	0.0002	349.9897	349.9896	0.0001
399.9912	399.9913	-0.0002	399.9912	399.9913	-0.0002

### 表 3 バジェット表

記号	不確かさ要因	値	確率 分布	序数	標準不確 かさ	感度係 数	標準不確かさ (mm)
σ(CMM)	CMMの測定の不確かさ	4.96E-05	-	1	4.96E-05	1	4.96E-05
σ(Mcali)	HSGの値付けの不確かさ	4.00E-04	正規	2	2.00E-04	1	2.00E-04

#### 長さに依存する項

長さに依存したい項

記号	不確かさ要因	値	確率 分布	序数	標準不確 かさ	感度係 数	1mm当たりの標 準不確かさ (mm)
σ(bias)	CMMの偏りの不確かさ	0.00E+00	F分布	1	0.00E+00	L	0.00E+00
σ(GB)	GBの表示値の不確かさ	4.70E-04	正規	2	2.35E-07	L	2.35E-07
$\sigma(T_digit)$	温度計の量子化の不確かさ	5.00E-02	矩形	1.732	2.89E-02	$L \times \alpha$	5.77E-10
σ(α)	HSGの線膨張係数の不確かさ	2.00E-08	矩形	1.732	1.15E-08	$L \times \Delta t$	1.15E-09

 $U(k=2)=2\times(0.00021^{2}+(2.35\times10^{-7} L)^{2})^{0.5} mm$ 

U(k=2)= 444 nm (L=350 mm)

ら除いた。必要であればHSG 測定の比例回帰式の不確か さ um により算出する (CMM 軸に平行な2 姿勢)。

$$u_m = \pm \sqrt{F_f^1(0.05) \frac{M^2}{M_1^2 + M_2^2 + \dots + M_k^2}} V_e \qquad (1)$$

ここで、 $F_f^1(0.05)$  は自由度fのF分布の5%の値、MはHSGの標準値、 $V_e$ は誤差分散である。

・ σ(GB): GB の表示値の不確かさ (B タイプ)

→ GBの校正証明書 (k=2)

- ・o(T\_digit): 温度計の量子化の不確かさ(Bタイプ)
  → 最小目盛 0.1℃の矩形分布
- ・σ(α): HSG の線膨張係数の不確かさ(Bタイプ)
  →メーカの提示値±0.02×10<sup>6</sup>°C<sup>-1</sup>、矩形分布
  以上の算出方法により値付けの不確かさ算出した。

#### 4-6 実験結果及び考察

表1にHPの測定結果、表2にHSGを使用して求めた CMMの目盛誤差、表3にHPの値付けの不確かさを示す。 表1の値は反転法D0、DX、DY、DZによる4姿勢で平 均値を算出し、その値に表 2 の目盛誤差を補正した結果 である。また、表1の値の分布する範囲が表3で示す拡 張不確かさ U(k=2)である。ちなみに、測定長さが 350mm 時の不確かさは444nmとなる。表3のバジェット表への 不確かさの配置は低熱膨張材型標準器を使用した CMM の中間点検の論文<sup>1)</sup>を参考にした。表3のバジェット表 から長さに依存しない項のHSGの値付けの不確かさが大 きく影響していた。通常の標準器の校正ではブロックゲ ージなど温度膨張材料が多くを占め、その場合では温度 膨張に起因する不確かさの影響から不確かさが大きく算 出される傾向が見られるが、ここでの低熱膨張材型標準 器の場合ではこの因子が無視できるため不確かさが小さ く算出された。

## 5 ホールプレートによる YZ 面の検査

### 5-1 測定の目的

HP を使用して CMM の YZ 平面の検査を行い、測定範 囲際の測定精度を求める。

# 5-2 固定方法

HP を利用した CMM の YZ 面の検査をした。HP の固 定方法は付属治具を利用して YZ 面上に平行にHP を直立 させた。写真 6、7 のとおり CMM テーブル上に付き当て 板を 2 箇所設置して、それに押し当てて HP を MCS に揃 えた。ZX 面における X 軸方向の出入りを図 7 の 2 箇所 で測定したところ、点 7 が X239.9809 mm、点 8 が X240.4564 mm から 0.4755 mm であった。XY 面における X 軸方向の出入りは点 9 が X240.3008 mm、点 10 が X240.0838 mm から 0.2170 mm であった。付属治具を含む HP は自重による設置方法として、クランプ等で直接 CMM テーブルに固定することはしなかった。

#### 5-3 測定物座標系



写真6 HPのYZ面の姿勢1



写真7 HPのYZ面の姿勢2



図7 直立姿勢での出入り測定



図8 使用したスタイラス

表4 YZ 面の誤差						
	XY 面内	ZX 面内				
xTx [um/m]	0.0		0.0			
yTy [um∕m]	0.0	-0.3				
zTz [um/m]	-	0.5	0.0			
xWy [urad]	0.0					
yWz [urad]		-0.3				
xWz [urad]			0.0			

HPの向きはNo.1 円からNo.8 円に向かう方向を+Y方向として設置し、空間軸の方向は+Xとした。WCSは3. ホールプレートへの値付けと同等とした。



#### 図 9 YZ 面の誤差

### 5-4 YZ 面の HP 測定

Forward+Backward 測定を繰り返し無しで行い、測定時 間は20分であった。スタイラスは図8に示す-X方向横 向きの $\phi$ 8mm チップの赤色ルビーを使用した。

### 5-5 YZ 面の HP の 測定での 温度変動

測定中の温度の平均値は19.3 ℃、変動幅は0 ℃であった。YZ 面の測定では、HP の線膨張係数がほぼ0 /℃であるため温度補正は行わなかった。

### 5-6 実験結果及び考察

表4と図9にYZ面の誤差を示す。ここで使用したHP の校正値は表1を使用した。つまり、HPを校正したCMM とYZ面を検査したCMMは同じものであり、今後に表1 の校正値の客観的な検証を要する。表4よりYZ面内で の誤差はY軸方向で $-0.3 \mu m/m$ 、Z軸方向で $0.5 \mu m/m$ となり検査長さ1mでの指示誤差2.4  $\mu m$ を大きく下回っ た。また、Z軸に対するY軸の直角度誤差は $-0.3 \mu rad$ と なり非常に小さい。XY面及びZX面は検査を実施してい ないため数値は0を示している。また、図9から誤差の 分布傾向は規則性は見られず、ランダムに分布する誤差 であることから CMM の校正及び仕様の分解能に依存す る誤差であると思われる。このことから、現状での CMM の状態は高精度測定に対応できる良い状態であることが わかった。

# 6 結 言

低熱膨張セラミックス製ホールプレートを使用して、 高精度 CMM によりホールプレートの値付け校正を行い 校正方法の様式化と値付けの不確かさを算出した。また、 校正値を与えたホールプレートを使用して CMM の性能 検査方法を試した結果、以下の結論が得られた。

- (1) 高精度 CMM で反転法により値付け校正した。トレー サビリティを付与するための標準器はホールステップ ゲージを使用した。その結果、校正値の不確かさは測定 長さ 350mm では U(k=2)=444nm と算出され、ブロック ゲージなど温度膨張材料に比較して低熱膨張材料の場 合では温度膨張に起因する因子が排除された結果、校正 値の不確かさが小さく算出される効果が見られた。
- (2) ホールプレートを使用した CMM の性能検査を試した。YZ 面にホールプレートを立てる姿勢では、低熱膨 張セラミックスの比重が鉄の 1/3 の特性効果により軽 量で操作性が容易であった。性能検査で得られた結果は、 YZ 面内での誤差は Y 軸方向で-0.3 µm/m、Z 軸方向 で 0.5 µm/m となり検査長さ1 m での指示誤差 2.4 µm を大きく下回り、CMM が良好な状態であることが確認 できた。

### 文 献

 和合健、ほか:座標測定機の中間点検手法の考察、 精密工学会誌、Vol.79、No.3、p241-247(2013)

### 謝 辞

本研究は、産業技術連携推進会議知的基盤部会計測分 科会形状計測研究会の共同研究として行われた。実験を 行うにあたり本共同研究に参加された NMIJ/AIST、公設 試及び企業の研究員の方々には貴重なご指導を頂き、こ の場を借りて感謝を表す。